

PlasmaTEC-X 常压等离子表面处理设备

新型设计 技术革新

产品特征:

- 安装简便
- 零电势的等离子工艺
- 处理速度快
- 数字/模拟控制信号
- 自动调整气流
- 待机节能气流控制
- 体积小, 重量轻
- 输出放电控制
- PlasmaREMOTE



Tantec的PlasmaTEC-X是根据常压下高压直流等离子放电原理而设计的新型表面处理设备。该设备既可以单独集成到机器人系统中,也可以集成到任一生产线上。

喷枪中的等离子需要在一定的气压下放电,释放出足够的能量,处理产品表面。不管气管有多长,PlasmaTEC-X主机都可以自动调机喷枪中的气流,因为内置的AirTEC系统可以为其源源不断的提供稳定气流。

AirTEC系统和统一的电源输入让PlasmaTEC-X使用更加简单方便。无需任何调整,只需要连接电源和压缩空气即可使用。

一个PlasmaREMOTE HMI控制器以菊花链模式同时控制1-8台PlasmaTEC-X主机。这些主机可以通过常规的继电器单独控制或作为一个整体用相同的主控制器信号通过数字界面进行控制。

该设备先进的设计是“待用空气流动”。通过HMI,操作员可以在待机状态下设定气流量,避免放电电极头吸附到灰尘。

PlasmaTEC-X主机的所有连接喷嘴的接口都是标准插口,因此使用就变得更加简单方便。基于直流电放电技术和AirTEC的设计,不论连接线缆有多长,都无需进行任何调整。

Head Office

Tantec A/S
Industrivej 6
DK-6640 Lunderskov
(+45) 7558 5822

Mail:
sales@tantec.com

Web:
www.tantec.com
www.china-tantec.com (中文)

中国区总代:
昆山市坦钛等离子科技有限公司

Tel:
0512-50333890

Mobile:
13862667395

Mail:
sales@china-tantec.com

特点:

- 安装简便 仅需连接电源和压缩空气，无需调节气压和电源。
- 零电势的等离子工艺 可处理导体、非导体和半导体产品表面。
- 速度快 等离子放电能量高，可适应高速生产线。
- 控制信号 在数字界面会显示各种不同的信号，实时控制和监控等离子放电。
- 自动调整气流 不论电源线或喉管的长度多长，主机都会自动调整，以保证提供适量的气压和气体流量。
- 待用气流 气流通过电子开关控制。一小部分气流备用，以避免放电电极头吸附到灰尘。
- 体积小，重量轻 该特性使得PlasmaTEC-X可以很轻松地集成到几乎任一生产线上或机器人系统中。
- 输出放电控制 若输出电压低于预设值，主机会发出警报信号。
- 控PlasmaREMOTE 该设备上的参数可以通过HMI控制器进行控制和调节。HMI控制器可以监视和控制1-8台PlasmaTEC-X。

技术参数	PlasmaTEC-X 主机	PlasmaREMOTE	PlasmaTEC-X 喷嘴
电源电压和频率	100-250VAC - 50/60Hz (统一的电源输入)	N/A	N/A
输出电压/功率	550VA	N/A	425watt
启动时间	10 ms	N/A	N/A
关机时间	< 1 ms	N/A	N/A
控制接口	M12 (8 帧)	M12 (4 帧)	N/A
规格 (宽x长x高)mm	150x470x198	125x169x167	OD30x206mm
重量 (kg	6,1	2,0	1,1 (包括2m的喉管)
处理宽度 mm	N/A	N/A	8-14mm
压缩气体	5-6 bar, 干燥清洁	N/A	N/A
压缩气体接口	OD8mm 快速连接	N/A	N/A
气体消耗量	N/A	N/A	33 ltr/min
每个 PlasmaREMOTE 可连接的数量	N/A	1-8 台 PlasmaTEC-X 主机	N/A
遵循法规	CE- RoHS - WEEE	CE- RoHS - WEEE	CE- RoHS - WEEE